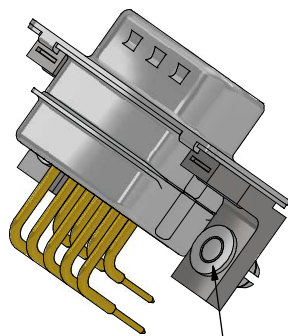
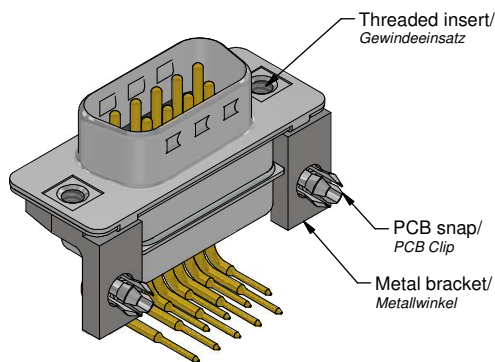


Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Capacitance value/ Kapazitätswert:
24-004241	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	2x 370 pF ± 20 %
24-004242	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-004241	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-004253	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	2x 830 pF ± 20 %
24-004252	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-004251	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-004263	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	2x 1300 pF ± 20 %
24-004262	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-004261	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	



Snap, press for fixing on PCB/
Clip, drücken zum Befestigen auf der
Leiterplatte

Technical specification/ Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung: IEC 664-1	100 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	5 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWW):	300 V DC
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 105 °C
Capacitance value/ Kapazitätswert:	see table/ siehe Tabelle
Mating cycles (see table)/ Steckzyklen (siehe Tabelle):	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/ Werkstoffe:

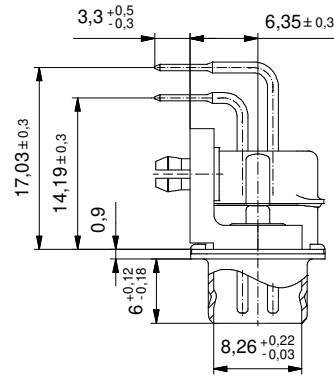
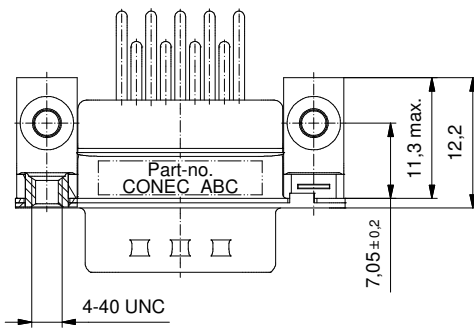
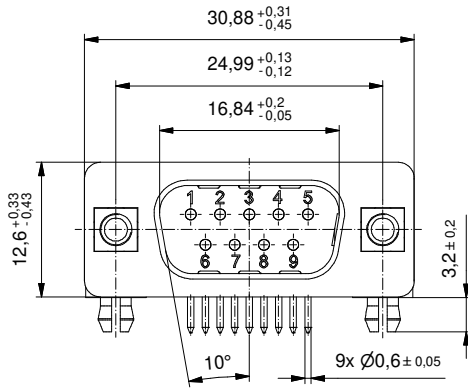
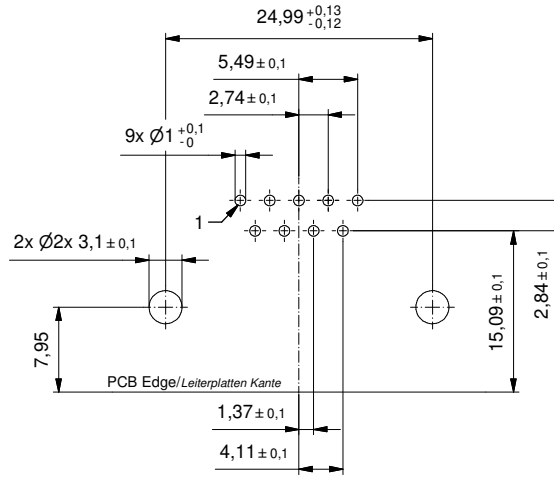
Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni Contact tails pretinned/ Kontaktspitzen verzinkt
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
PCB snap/ PCB Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/ Montagedaten:

Solder parameter/ Lötparameter:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	100 °C for 30 sec./ 100 °C für 30 Sek.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	260 °C for 5 sec./ 260 °C für 5 Sek.
PCB hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB snap for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm

		dim. in mm		D-SUB PI-Filter Male 90° 9pos. 0.590 inch with threaded insert, metal bracket and PCB snap D-SUB PI-Filter Stiftleiste 90° 9pol. 14,19 mm mit Gewindeinsatz, Metallwinkel und PCB Clip	
		Date/Datum	Name		
		drawn/ gez.	24.03.2022 Henneboel		
		appd./ gepr.	24.03.2022 Lehmannkühler		
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 24K1A2234		DIN- A3	
RoHS compliant/konform		CONEC®		1 / 2	

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



This reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. We reserve the right to withdraw advertising and notices, in whole or in part, at any time without notice and without obligation.

		dim. in mm		D-SUB PI-Filter Male 90° 9pos. 0.590 inch with threaded insert, metal bracket and PCB snap D-SUB PI-Filter Stiftleiste 90° 9pol. 14,19 mm mit Gewindeinsatz, Metallwinkel und PCB Clip	
		Date/Datum	Name		
		24.03.2022	Henneboel		
		appd./gepr.	Lehmenkühler		
Index: a Original	scale/Maßstab:			dwg no / Z.-nr.:	24K1A2234
RoHS compliant/konform	2:1			DIN-A3	2 / 2